【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和6年8月13日(2024.8.13)

【国際公開番号】WO2023/100553
【出願番号】特願2023-564807(P2023-564807)
【国際特許分類】
Ｇ０３Ｆ　7/11(2006.01)
Ｇ０３Ｆ　7/004(2006.01)
Ｇ０３Ｆ　7/40(2006.01)
Ｂ３２Ｂ 27/32(2006.01)
Ｇ０６Ｆ　3/041(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０３Ｆ　7/11　５０１
Ｇ０３Ｆ　7/004５１２
Ｇ０３Ｆ　7/40　５２１
Ｂ３２Ｂ 27/32　　Ｚ
Ｇ０６Ｆ　3/041６６０

【手続補正書】
【提出日】令和6年4月23日(2024.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
仮支持体と、感光性組成物層と、保護フィルムとをこの順に有する転写フィルムであって、
前記保護フィルムが、ポリプロピレンを含み、
前記保護フィルムの前記感光性組成物層側の表面の算術平均粗さＲａ１が、前記保護フィルムの前記感光性組成物層とは反対側の表面の算術平均粗さＲａ２よりも小さい、転写フィルム。
【請求項２】
前記算術平均粗さＲａ１が、０．０５０μｍ以下である、請求項１に記載の転写フィルム。
【請求項３】
前記算術平均粗さＲａ２が、０．０５０μｍ超である、請求項１又は２に記載の転写フィルム。
【請求項４】
前記算術平均粗さＲａ２が、０．１５０μｍ未満である、請求項１又は２に記載の転写フィルム。
【請求項５】
前記算術平均粗さＲａ１が、０．０５０μｍ以下であり、前記算術平均粗さＲａ２が、０．０５０μｍ超０．１００μｍ以下である、請求項１又は２に記載の転写フィルム。
【請求項６】
前記算術平均粗さＲａ１に対する前記算術平均粗さＲａ２の比が、１．７以上である、請求項１又は２に記載の転写フィルム。
【請求項７】

前記算術平均粗さＲａ１が、０．０５０μｍ以下であり、前記算術平均粗さＲａ２が、０．０５０μｍ超０．１００μｍ以下であり、
前記算術平均粗さＲａ１に対する前記算術平均粗さＲａ２の比が、１．７以上である、請求項１又は２に記載の転写フィルム。

【請求項８】
前記保護フィルムの厚さが、１０～３０μｍである、請求項１又は２に記載の転写フィルム。

【請求項９】
請求項１又は２に記載の転写フィルムを用いて形成した、導体パターンを有する積層体。

【請求項１０】
請求項１又は２に記載の転写フィルムから、前記保護フィルムを剥離して前記感光性組成物層の表面を露出させる剥離工程と、
前記感光性組成物層の露出した表面が、表面に導電層を有する基板の前記導電層と接するように、前記転写フィルムと前記導電層を有する基板とを貼合する貼合工程と、
前記感光性組成物層を露光する露光工程と、
露光された前記感光性組成物層に対して現像処理を実施してレジストパターンを形成する現像工程と、
前記レジストパターンが配置されていない領域にある前記導電層に、エッチング処理を行うエッチング工程、及び、めっき処理を行うめっき処理工程のいずれか１つと、
前記レジストパターンを剥離するレジストパターン剥離工程と、
更に、前記めっき処理工程を有する場合は、前記レジストパターン剥離工程によって露出した前記導電層を除去し、前記基板上に導体パターンを形成する除去工程と、を有する、導体パターンを有する積層体の製造方法であって、
前記貼合工程と前記露光工程との間、又は、前記露光工程と前記現像工程との間に、更に、前記仮支持体を剥離する仮支持体剥離工程を有する、導体パターンを有する積層体の製造方法。

【請求項１１】
仮支持体上に感光性組成物層を形成する工程と、
前記感光性組成物層の前記仮支持体とは反対側の面に保護フィルムを貼合する工程とを含む転写フィルムの製造方法であって、
前記保護フィルムが、ポリプロピレンを含み、
前記保護フィルムの前記感光性組成物層側の表面の算術平均粗さＲａ１が、前記保護フィルムの前記感光性組成物層とは反対側の表面の算術平均粗さＲａ２よりも小さい、転写フィルムの製造方法。